

TIA N-MEMS シンポジウム「MNOIC 装置セミナー」

「ツール de MNOIC -先端 NMEMS 拠点見学と研究開発ツール紹介-

開催日：2012年2月14日（火曜日） 13時20分から17時10分
（但し、MNOIC 装置見学会は11時20分から12時15分まで）
開催地：産総研・東事業所 NMEMS イノベーション棟（4G棟）
国際セミナー室（1F ロビー横）
連絡先およびアクセス：<http://mnoic.la.coocan.jp/access/index.html>（つくば開発センター）
掲載：http://www.aist.go.jp/aist_j/guidemap/tsukuba/east/tsukuba_map_e.html
主催：一般財団法人マイクロマシンセンター MNOIC
共催：集積マイクロシステム研究センター（独立行政法人・産業技術総合研究所）
後援：つくばイノベーションアリーナナノテクノロジー拠点運営最高会議

【趣旨】

TIA（つくばイノベーションアリーナ）も2年目を迎え、TIAでのMEMS関連(TIA N-MEMS)の活動も順調に推進しています。特にTIA N-MEMS 研究プラットフォームを活用するMNOICは2011年4月に設立、8月にHPにご案内して受付を開始し、既に沢山の法人の方々から申し込みを頂いて活用を開始しています。

今回、「MNOIC 装置セミナー」として世界最先端のMEMS装置群に関して、装置メーカーからの口頭発表と、ポスター発表を行う場を設定致しました。同時に世界最先端のMEMS研究で知られる東北大学江刺教授による特別講演や集積マイクロシステム研究センター(UMEMSME)の最先端技術紹介・MNOIC利用の個別相談会も併せて設定致しました。皆様の積極的なご参加を期待しています。

【プログラム】

1. 第一部 (13:20-14:00) (司会 三原 孝士)
 - 主催者挨拶 今仲 行一 MNOIC 所長
 - 主催者挨拶 前田 龍太郎 UMEMSME センター長
 - 特別講演
「MEMS 装置に関する MEMS プロセス・パッケージング・テスト技術」
江刺 正喜 東北大学 教授
2. 第二部 世界最先端大口径 MEMS 製造装置のご紹介 (14:00-15:30) (座長 荒川 雅夫)
 - マスクレス露光装置 東芝機械(株) 後藤 博史
 - マスク露光装置 イーヴィグループジャパン(株) 川野 連也
 - ウェハ検査装置 (株)モリテックス 井上 淳也
 - ウェハ接合装置 ボンドテック(株) 山内 朗
 - 犠牲層ドライエッチング装置 キヤノンマーケティングジャパン(株) 山本 仁
 - X線 CT 評価装置 キヤノンマーケティングジャパン(株) 川内 篤史
3. 第三部 UEMSME 最先端プロセス技術と MNOIC 利用 (15:30-16:00) (座長 原田 武)
 - 強誘電体薄膜材料の MEMS への適用とそのプロセス技術
UMEMSME 小林 健
 - MNOIC の利用に関して MNOIC 研究企画 三原 孝士

【 休憩 (16:00-16:10) 】

4. 第四部 ポスターセッションと MNOIC 個別相談会 (16:10-17:10)

【 場所：国際セミナー室にて (MNOIC 個別相談は 4F MNOIC 研究居室にて) 】

- 世界最先端大口径 MEMS 製造装置群のポスターご紹介
- UMEMSME 関連の最先端研究状況ポスターおよび関連技術展示
- MNOIC 個別相談会 (ご希望者は申し込み時、あるいは受付時にお申し込みください)

	装置名	会社名	展示概要
1	ウェハ洗浄装置ほか	(株)日立ハイテクトレーディング	ウェハのセミオートスピン洗浄・乾燥装置
2	異方性エッチング装置ほか	(株)カナメックス	ウェハ揺動による高均一性エッチング
3	マスク露光装置、接合装置	イーヴィグループジャパン(株)	高段差対応、両面アライメント、プロキシミティ露光
4	マスクレス露光装置	東芝機械(株)	大口径ウェハへの DMD によるレーザスキャン直描
5	TEOS-CVD、TSV への応用	サムコ(株)	高アスペクト TSV に適した低温 SiO ₂ プラズマ CVD 成膜
6	縦型炉	光洋サーモシステム(株)	カセットツーカーセット 25 枚バッチ半量産装置
7	ICP ドライエッチング装置	パナソニック(株)	低フットプリント SiO ₂ 、メタル ICP ドライエッチング
8	大口径 Si 深堀ドライエッチ装置	SSP テクノロジーズ(株)	8 インチ、12 インチボッシュプロセス DeepRIE 装置
9	犠牲層ドライエッチ装置	キャノンマーケティングジャパン(株)	SiO ₂ 犠牲層リリースエッチング、撥水膜コーティング装置
	産業用 X 線 CT 装置		X 線撮像による 3D 構造の非破壊評価装置
10	光学検査装置	(株)モリテックス	ウェハレベル自動光学顕微鏡観察欠陥検査装置
11	チップ to ウェハ/ウェハ接合装置	ボンドテック(株)	プラズマクリーニングによるウェハレベル低温接合
12	測長・分析 SEM	(株)日立ハイテクノロジーズ	チップから 12 インチウェハまでの多目的 SEM 観察
13	MEMS テスター	エスティケイテクノロジー(株)	セミオートウェハレベルプローバテスター
14	MemsONE	みずほ情報総研(株)	純国産の MEMS 用設計解析支援システムソフトウェア
15	ミニマルファブ	(独)産業技術総合研究所	超小型ウェハによる枚葉処理半導体プロセス装置
16	大面積電鍍金型技術	池上金型工業(株)	12 インチ対応金型電鍍プロセス技術
17	検討中	ナノクラフトテクノロジーズ(株)	検討中
18	検討中	マリモ電子工業(株)	検討中
19	検討中	(有)VIYIA	検討中
20	検討中	(株)D-process	検討中

5. 第五部 懇親会(17:15-19:00) 国際セミナー室

- 乾杯の挨拶 一般財団法人マイクロマシンセンター 青柳 桂一 専務理事
会費制 2000円 (領収書をご用意致します)

MNOIC 見学会のご案内

- 2012年2月14日（火曜日） 11時20分から12時15分まで
（MNOIC 装置セミナーは13時20分から）
- 集合場所： 産総研・東事業所 NMEMS イノベーション棟（4G棟）
NMEMS イノベーション棟の1F 玄関に11時20分集合
<http://mnoic.la.coocan.jp/access/index.html>（つくば開発センター）
http://www.aist.go.jp/aist_j/guidemap/tsukuba/east/tsukuba_map_e.html

【その他】

ポスターセッションのテーマリストは別途、MNOIC の HP、
<http://mnoic.la.coocan.jp/>
および UMEMSME の HP
<http://unit.aist.go.jp/umemsme/ci/index.html>
に公開致します。

【参加申込】

必要事項をご記入の上、下記の申込先へ E-mail 又は FAX をお願いします。
・参加費用（MNOIC 装置セミナー）：無料
・懇親会参加費用：2000 円

■申込先：

一般財団法人マイクロマシンセンター MNOIC開発センター（つくば）
水谷 恵美 宛
〒305-8564 茨城県つくば市並木1-2-1
（独）産業技術総合研究所 東事業所内 NMEMSイノベーション棟4階
TEL：029-886-3471
FAX：029-886-3472
e-mail：e_mizutani@mmc.or.jp

※申込締切り：平成24年2月13日（月）

定員（150人）になり次第締め切りさせていただきます。

===== お申込は下記の申込欄をご送信下さい。 =====

2012年2月14日（火）「MNOIC 装置セミナー」参加申し込み

- 申込者氏名：
- 氏名フリガナ：
- 会社・団体名：
- 所属部署：
- 役職：
- E-mail：
- TEL：
- FAX：

以下の項目別の参加申し込みをお願いします。○で囲むか、或いは不要な部分を削除してください。

- (1) MNOIC 装置セミナー（13時20分から17時10分）
- (2) MNOIC 装置見学会（11時20分から12時15分）
- (3) 懇親会（有料）
- (4) MNOIC 個別相談会

【お問合せ】

一般財団法人マイクロマシンセンター MNOIC開発センター（つくば）
水谷 恵美(Emi MIZUTANI)
〒305-8564 茨城県つくば市並木1-2-1
（独）産業技術総合研究所 東事業所内NMEMSイノベーション棟4階
TEL：029-886-3471
FAX：029-886-3472
[e-mail：e_mizutani@mmc.or.jp](mailto:e_mizutani@mmc.or.jp)
<http://www.mmc.or.jp/>
